揚博科技股份有限公司
Ampoc Far-East Co., Ltd.

2025/09/24

法說會

免責聲明

This presentation is prepared by the Company based on the current status and future outlook. It may contain forward-looking statements, including expectations and projections regarding future operating performance, financial condition, market demand, or other matters. Such forward-looking statements are subject to various known and unknown risks, uncertainties, and other factors, and actual results may differ materially from those expressed or implied herein.

The Company undertakes no obligation to update or revise the contents of this presentation to reflect subsequent events or circumstances. Investors should exercise their own independent judgment and be aware of investment risks when evaluating the Company.

The financial, business, and other information contained in this presentation is provided for reference only and does not constitute any investment advice or solicitation. The Company, its directors, officers, and agents assume no liability for any losses or damages arising from the use of this presentation.

本簡報所載資料係本公司基於目前狀況及未來展望所編製，內容可能包含前瞻性陳述例如對未來營運績效、財務狀況、市場需求或其他事項的預測與期望。此類前瞻性陳述可能受多項已知與未知之風險、不確定性與其他因素影響，實際結果可能與所述情形有重大差異。

本公司無義務隨時更新或修正本簡報內容，以反映後續情勢或其他影響因素。投資人於評估本公司時，應自行審慎判斷，並注意投資風險。

本簡報所載之財務、業務數據及相關資訊僅供參考，不構成任何投資建議或邀約。本公司及其董事、經理人或代理人，對因使用本簡報內容所生之任何損失或責任，概不承擔。

CONTENTS

- 公司簡介
- 公司現況
- 財務資訊
- 自製設備產品介紹與展望
- 代理業務產業應用與展望

01 公司簡介

公司簡介

創立於
1976年

資本額
12.68億

營業額
36.58億

員工人數
350人

1976年-草創

1980-1990年

- 揚博企業股份有限公司成立，股本 100 萬元。
- 日本 TCM 於中壢工業區設立台北化工機械股份有限公司，產製 PCB 濕製程設備，本公司除參與投資外並取得日本以外全球獨家銷售權。

1991-2000年

- 購入台北市松德路171號17樓為揚博科技企業總部。
- 獲准成為公開發行公司。
- 合併台北化工機械股份有限公司。

2001-2010年

- 申請公司名稱變更為「**揚博科技股份有限公司**」，盈餘轉增資，股本增加為 90,500 萬元。
- 經證管會核准於 2002/1/23 股票掛牌上市，代號 **2493**。

2011-2020年

- 開發Ampoc Wing，正式交貨予客戶投入生產。
- 董事會通過香港設立子公司。
- 透過香港子公司投資揚博上海子公司。

2021-迄今

- 企業永續經營，成立永續發展委員會。
- 發展ECO System熱交換系統。
- 2023年新購南園路廠房因應未來業務發展。
- 2025年成立 AMPOC FAR-EAST (THAILAND) CO., LTD.

02 公司現況

公司現況

~揚博科技以服務電子產業為職志，積極扮演資訊電子產業之橋樑~

董事長：蘇勝義

2大事業處

- 製造管理處
- 營業管理處

4大核心

- 高階製造
- 高科技研發
- 半導體先進製程
- 節能減碳

9大思維

- 品質第一
- 創新求進
- 專業導向
- 流程改善
- 全員經營
- 產銷國際
- 服務至上
- 社會責任
- 永續經營

3大技術

- Ampoc Wing
- Ampoc ECO
- Ampoc 7A

03 財務資訊

最近年度合併綜合損益表

單位：新台幣仟元

項目 \ 年度	112年度	113年度	114年上半年度
營業收入	3,354,285	3,657,780	1,837,898
營業毛利	1,219,708	1,236,832	566,848
毛利率(%)	36.36	33.81	30.84
營業利益	836,161	818,984	355,252
稅後淨利	690,310	692,598	227,822
每股盈餘(元)	6.03	6.05	1.99

最近年度合併資產負債表

單位：新台幣仟元

項目 \ 年度	112年	113年	114年上半年
流動資產	3,869,784	3,286,628	3,691,087
非流動資產	1,113,823	1,137,382	1,172,595
資產總額	4,983,607	4,424,010	4,863,682
流動負債	1,709,646	1,127,374	1,847,726
非流動負債	273,407	147,527	125,937
負債總額	1,983,053	1,274,901	1,973,663

最近年度財務分析

項目 \ 年度	112年	113年	114年上半年
負債佔資產比(%)	39.79	28.82	40.58
流動比率(%)	226.35	291.53	199.76
存貨周轉率(次)	1.86	2.54	2.87
權益報酬率(%)	23.95	22.52	7.54

04 製造管理處

自製設備產品介紹與展望

自製設備產品介紹

AMPOC SUPER DRY SYSTEM 專利

证书号第23158584号

专利公告信息

实用新型专利证书

实用新型名称：加强型板材干燥装置

专 利 权 人：扬博科技股份有限公司

地　　址：中国台湾台北市信义区松德路171号17楼

发 明 人：苏胜义;巫坤星;吕理榕;锺添达;杨延鸿

专　利　号：ZL 2024 2 2340932.2　　授权公告号：CN 223179223 U

专利申请日：2024年09月25日　　授权公告日：2025年08月01日

申请日时申请人：扬博科技股份有限公司

申请日时发明人：苏胜义;巫坤星;吕理榕;鐘添达;杨延鸿

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法进行审查，决定授予专利权，并予以公告。

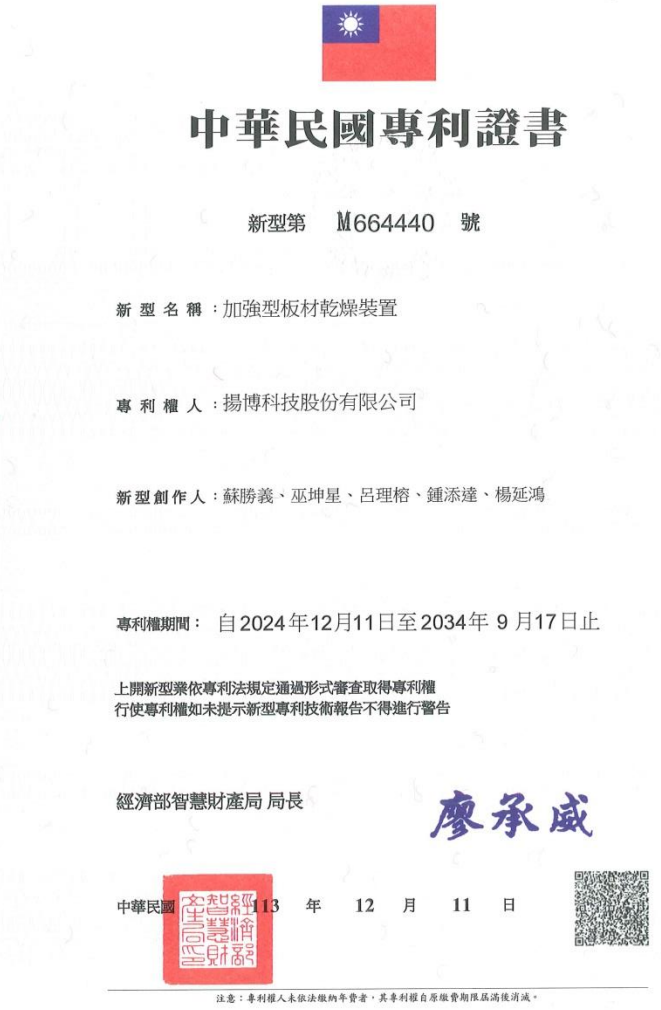
专利权自授权公告之日起生效。专利权有效性及专利权人变更等法律信息以专利登记簿记载为准。

局长
申长雨

国家知识产权局

2025年08月01日

第 1 页 (共 1 页)



中華民國專利證書

新型第　M664440　號

新型名稱：加強型板材乾燥裝置

專利權人：揚博科技股份有限公司

新型創作人：蘇勝義、巫坤星、呂理榕、鍾添達、楊延鴻

專利權期間：自2024年12月11日至2034年 9 月17日止

上開新型業依專利法規定通過形式審查取得專利權
行使專利權如未提示新型專利技術報告不得進行警告

經濟部智慧財產局 局長　廖承威

中華民國 113 年 12 月 11 日

注意：專利權人未依法繳納年費者，其專利權自原繳費期限屆滿後消滅。

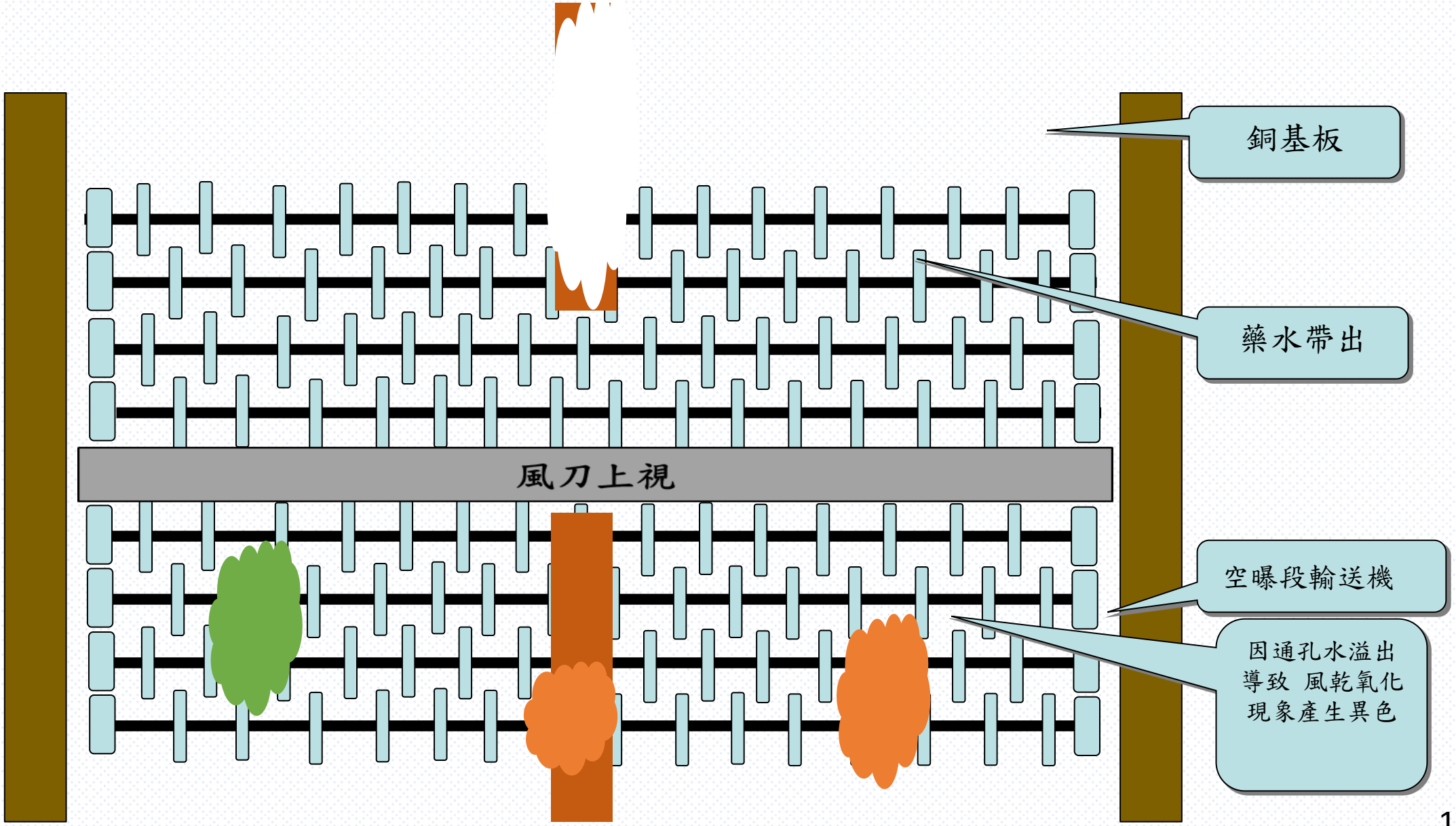
AMPOC SUPER DRY SYSTEM

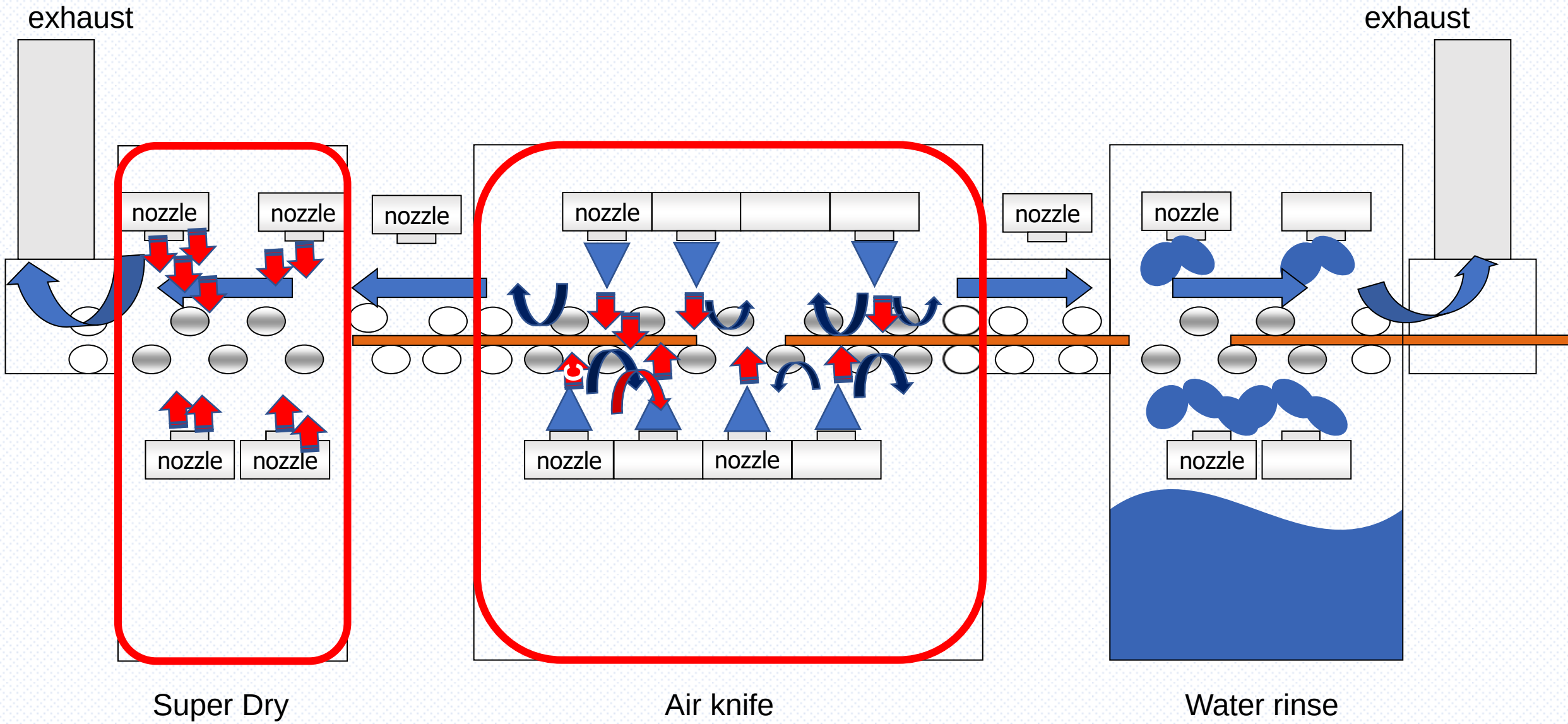
1.目的： 完全去除孔內殘留水分，特別針對高縱橫比孔（Aspect Ratio），防止氧化與品質劣化。

2.技術細節：

- 使用潔淨乾燥空氣，經特殊處理去除空氣中的水分與微粒。
- 具備極低露點，確保乾燥效果。
- 對於深孔或微孔結構，能深入孔內，徹底排除水分。
- 有助於防止氧化、提升導通孔品質與可靠性。

空曝段俯視圖




exhaust
exhaust
nozzle
nozzle
nozzle
nozzle
nozzle
nozzle
nozzle
nozzle
nozzle
nozzle
nozzle
Super Dry
Air knife
Water rinse

自製設備回顧與展望

2025年上半年回顧與未來展望

一、2025年上半年主要自製設備用途主要仍以載板及HDI、類載板佔比較高，應用市場包含、高速運算、電動車（EV）、先進駕駛輔助系統（ADAS）以及高速網絡和低軌衛星無線通信等高值化趨勢。

二、參展今年10月22-24日TPCA，除了展出7A專利產品與玻璃載板設備外，其中ECO 熱回收系統在超過500家企業激烈競逐中，憑藉自主研發實力，一舉榮獲第23屆金鋒獎「十大傑出創新研發」大獎，對因應地球暖化節能的趨勢，協助客戶的節能減碳減廢是有很大的貢獻。

三、面對客戶轉進東南亞設廠，設立AMPOC FAR-EAST (THAILAND) CO., LTD.，就近與客戶作密切溝通及售後服務及掌握商機。

四、無論國際局勢如何，持續開發新技術滿足客戶需求是我們生存的方式！

2025年上半年回顧與未來展望

未來設備研發與需求展望：

1.厚大板、高階載板及未來玻璃載板製程設備需求。

2.各PCB廠跨入高階產品競爭，包括5G相關載板、類載板、HDI、軟板設備未來需求。

3.智慧電動汽車與安全相關PCB設備需求。

4.節能減廢及無塵設備持續研發。

05

營業管理處

代理業務產業應用與產品介紹

先進封裝設備/材料/檢測解決方案

營業管理處方向與佈局

- 營管處2025年方向及布局：
  - ◆ 方向：
    - 高階封裝製程材料設備(COWOS/COWOP/Bonding/Inspection)
    - 黃光製程材料導入海內外廠商

■ **材料**

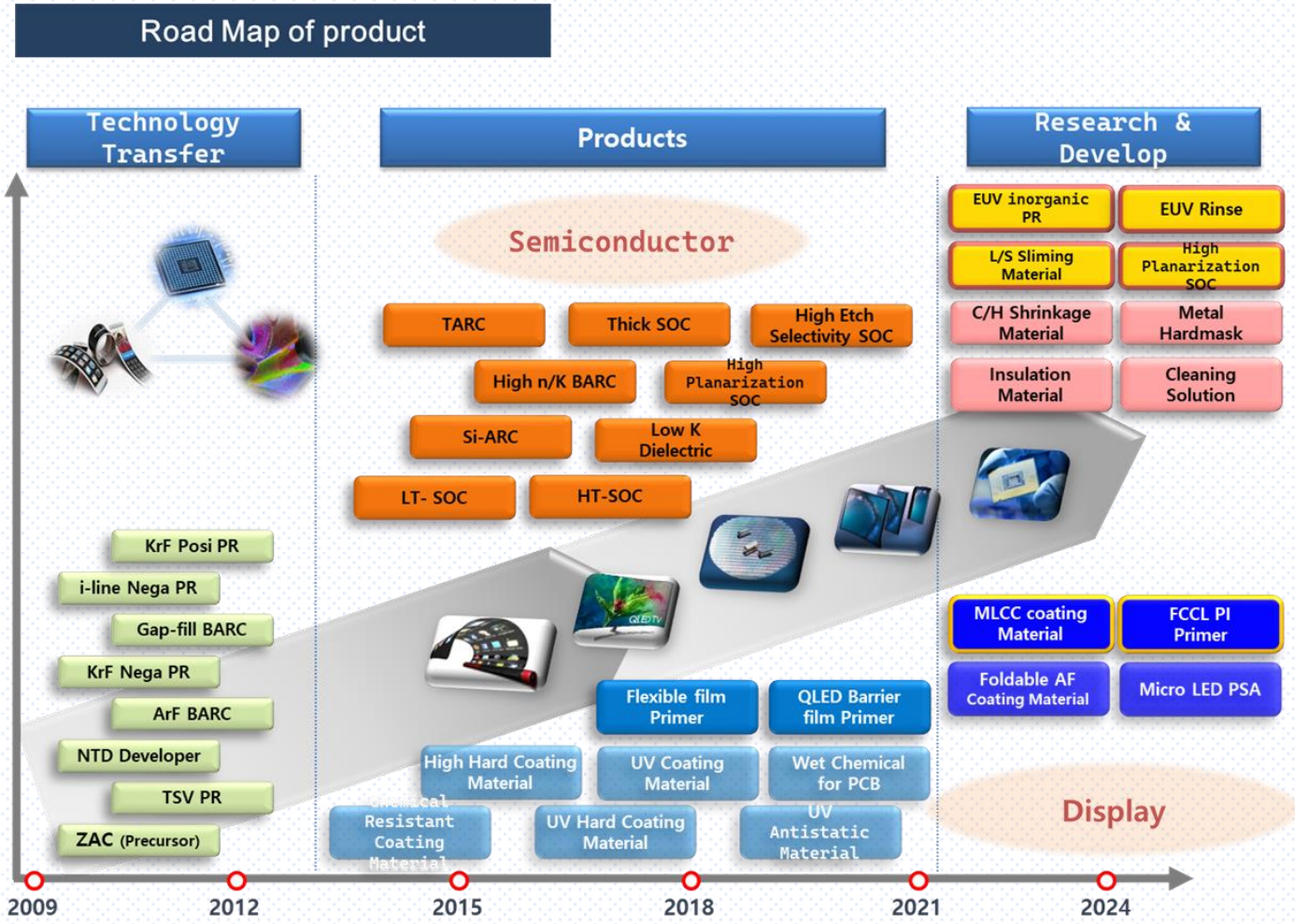
先進製程封裝材料

- Micro Bumping/SnAg(目前已提供客戶量產)
- Cu Pillar(目前已提供客戶量產)
- 同時也與客戶共同發展次世代的產品

黃光材料 (Lithograph material)

- 目前已取得客戶Approval 且已經放量生產中(依客戶產能增加而增加)
- 台灣/海外半導體廠測試中

黃光製程產品概況


Road Map of product
Technology Transfer
Products
Research & Develop
Semiconductor
TARC
Thick SOC
High Etch Selectivity SOC
High n/K BARC
High Planarization SOC
Si-ARC
Low K Dielectric
LT- SOC
HT-SOC
KrF Posi PR
i-line Nega PR
Gap-fill BARC
KrF Nega PR
ArF BARC
NTD Developer
TSV PR
ZAC (Precursor)
Flexible film Primer
QLED Barrier film Primer
High Hard Coating Material
UV Coating Material
Wet Chemical for PCB
Resistant Coating Material
UV Hard Coating Material
UV Antistatic Material
Display
EUV inorganic PR
EUV Rinse
L/S Sliming Material
High Planarization SOC
C/H Shrinkage Material
Metal Hardmask
Insulation Material
Cleaning Solution
MLCC coating Material
FCCL PI Primer
Foldable AF Coating Material
Micro LED PSA
2009
2012
2015
2018
2021
2024

■ 設備

- **3D Inspection system (WOSOP/FOPLP)**

功能：用於Bonding之前之形貌量測。

目的：先進製程封裝時會產生變異，此設備量測之後可以得到大量的形貌數據，大幅提升bonding的良率。

(2024/Q4取得訂單，目前裝機中)

2024-2025年回顧與展望

■ 外部環境影響 — 關稅與匯率

目前雖然無直接的影響 ，但是間接影響是我們必須小心應對。

■ 未來策略重點

1. 材料業務：加速國內及海外半導體廠的認證進程，預計 Q4 開始進入量產並反映在營收上。
2. 設備業務：鎖定高階封裝廠，深化 3D 形貌檢測系統的導入案例，建立技術門檻與市場口碑。
3. 風險控管：持續關注國際關稅政策變化與匯率走勢，適時調整採購及定價策略。

感謝聆聽
Thank you!